

ICS 31.180
L 30



中华人民共和国国家标准

GB/T 16261—1996
IEC/PQC 88:1990

印制板总规范

Generic specification printed boards

1996-03-22 发布

1996-10-01 实施

国家技术监督局 发布

目 次

1 总则	1
1.1 范围	1
1.2 目的	1
1.3 有关文件	1
1.4 总的考虑	1
1.5 规范结构	2
2 特定规定	2
2.1 初始制造阶段	2
2.2 结构类似印制板	2
2.3 合格试验记录(RCE)	3
2.4 延期交货	3
2.5 完成B组检验前的交货放行	3
2.6 拒收批的再提交	3
2.7 印制板及其包装标志	3
2.8 订货资料	3
3 能力批准和能力批准的维持	3
3.1 概述	3
3.2 能力批准要求	3
3.3 能力描述	3
3.4 合格产品一览表(QPL)	4
3.5 能力试验	4
3.6 能力批准试验报告	5
3.7 能力批准范围	5
3.8 能力批准的维持	5
3.9 能力批准的暂停和撤销	6
3.10 能力批准试验样本大小和失效数	6
3.11 能力详细规范(CapDS)中的检测资料	6
4 质量一致性检验	6
4.1 检验批	6
4.2 小批量和/或昂贵的印制板	6
4.3 试验分组	6
4.4 用户详细规范(CDS)中的检验资料	7
4.5 工序检验	7
4.6 间接测试方法	7
5 详细规范的编制规则	7
5.1 能力详细规范(CapDS)	7
5.2 用户详细规范(CDS)	8
附录 A 用户详细规范(CDS)示例	11

附录 B IEC,CECC 规范结构	12
附录 C QPL 资料格式示例	13
附录 D GB/T 16261 系列规范中使用的缩写字母	13

中华人民共和国国家标准

印制板总规范

GB/T 16261—1996
IEC/PQC 88:1990

Generic specification printed boards

本标准等同采用国际电工委员会电子元器件质量评定体系标准 IEC/PQC 88《印制板总规范》(1990年版)。

1 总则

1.1 范围

本规范是欧洲电工标准化委员会(CENELEC)电子元器件质量评定体系中印制板的总规范(GS),它与准备好安装元器件的印制板有关,而与它们的制造方法无关。

1.2 目的

本规范的目的是为批准制造厂及其产品而确定其评定体系和程序,并为制定印制板规范提供制定规则。

1.3 有关文件

IEC 194 印制电路术语和定义

IEC 249 印制电路用覆箔基材

IEC 326-2 印制板试验方法

CECC 00114/Ⅲ 电子元器件制造厂的能力批准程序

SJ/Z 9007 计数检查抽样方案和程序(idt IEC410)

1.4 总的考虑

印制板有下列重要因素不同于大多数其他元器件,如:

- 无具有标准图形和尺寸的标准板,而有无数变型和电路图形;
- 它们是“客户定作的”,即某特定印制板的所有细节必须由客户与制造厂协商;
- 尽管其总产量相当大,但某特定印制板的产量也可能是很小的。

因此,CECC00107 第 I 部分“通用质量评定程序”中阐述的 CECC 鉴定批准程序是不适用的,有必要使用 CECC 00114 第Ⅲ部分规定的《CECC 能力批准程序》¹⁾。

印制板的能力批准是基于使用作为能力鉴定元器件的综合试验图形,并选用合适的试验方法和要求,对下列各种印制板进行鉴定:

- 无金属化孔单、双面印制板;
- 有金属化孔单、双面印制板;
- 多层印制板;
- 挠性印制板。

注:上列印制板类型不齐全。

采用说明:

1) 新发布的 CECC 00114 第Ⅲ部分代替原 CECC 00107 的第Ⅲ部分。